

立即发布

投资者关系:

Ed Lockwood
投资者关系高级总监
(408) 875-9529
ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系:

Meggan Powers
企业宣传高级总监
(408) 875-8733
meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 宣布其光刻 / 蚀刻工艺控制系列新增两款产品

*新型测量与检测工具有助于为生产 20nm
以下存储器及微处理器芯片提供先进的图案技术*

【加州 MILPITAS 2013 年 2 月 25 日讯】在国际光学工程学会 (SPIE) 先进光刻会议上，KLA-Tencor 公司（纳斯达克股票代码：KLAC）宣布，推出其 SpectraShape™ 9000 光学关键线宽 (CD) 测量系统和 BDR300™ 晶圆背面缺陷检测与检验模块。SpectraShape9000 是一款新型测量系统，能够监测三维晶体管、存储单元和其他关键结构的形状，用于生产高性能的存储器与微处理器芯片。BDR300 能够检测和检验晶圆背面的缺陷，这些缺陷会引起晶圆正面的图案问题。这两款新型系统的设计目标是要实现 20nm 以下设计规则集成电路的批量生产。

KLA-Tencor 首席营销官 Brian Trafas 博士表示：“在这个高度扩展的 193nm 浸润式光刻时代，我们的客户正在若干前沿领域进行创新，以应对光刻和蚀刻领域变得异常严格的工艺容差。在这方面，我们今天推出的两款产品能够解决两个关键工艺控制问题：曝光扫描机的聚焦相关缺陷，以及鳍式场效应晶体管 (FinFET)、垂直堆叠的 NAND 和其他三维结构因形状微小偏差而引起的故障或性能不良。BDR300 和 SpectraShape 9000 旨在帮助我们的客户从容应对他们如今在光刻和蚀刻领域所面临的巨大挑战。”

新型 SpectraShape 9000 采用了激光驱动的等离子光源，并取得了数项其他巨大进步，使之能够针对多种材料和结构均具备前沿的尺寸测量能力。为了满足业界对 20nm 以下节点更加严格的工艺控制需求（需要在更多站点测量每片晶圆的更多位置），SpectraShape 9000 比之前的产品具有更高的灵敏度和吞吐率。它还支持专为多次光刻而设计的创新测量目标。

CIRCL™ 组合工具中的新型 BDR300 背面检测与检验模块与其前任相比，缺陷灵敏度具有显著改善，让晶圆厂能够发现晶圆背面的亚微米级缺陷，这些缺陷聚在一起，将影响高级节点的成品率。CIRCL 组合工具现在可以作为一套独立的晶圆背面检测与检验系统供应，其配置设计可以支持不断增长的业界需求，在晶圆进入曝光扫描机之前先对晶圆背面进行检测。晶圆背面保持洁净，能够减少污染曝光扫描机卡盘并影响后续产品的几率。

逻辑电路与内存芯片的领先制造商已经安装了多套 SpectraShape 9000 形状测量系统，以取代现有的 CD / 形状测量工具，用于新的技术开发，提升或满足对测量产能的更高要求。包含

BDR300 模块的首套 CIRCL 组合工具也已安装，用于主动监测曝光扫描机以及传统的显影后缺陷检测。为了保持高性能和高产能，满足最先进的生产需要，SpectraShape 和 CIRCL 系统由 [KLA-Tencor 的全球综合服务网络](#) 提供支持。

关于 SpectraShape 9000 系统的更多信息，请浏览 [SpectraShape 产品网页](#)。关于 BDR300 模块或 CIRCL 系统的更多信息，请浏览 [CIRCL 产品网页](#)。

关于 KLA-Tencor:

KLA-Tencor 公司是工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商，它与全球客户合作，开发先进的检测与计量技术。这些技术为半导体、发光二极管 (LED) 及其他相关纳米电子产业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队，超过三十五年以来一直致力于为客户打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 的总部设在美国加利福尼亚州米尔皮塔斯 (Milpitas)，并在全球各地设有专属的客户运营与服务中心。如需更多信息，请访问网站 www.kla-tencor.com (KLAC-P)。

前瞻性声明:

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 SpectraShape 9000、CIRCL 或 BDR300 的预期性能，半导体产业的趋势及其带来的预期挑战，KLA-Tencor 的客户对 SpectraShape 9000、CIRCL 或 BDR300 的预期使用，SpectraShape 9000、CIRCL 或 BDR300 与 KLA-Tencor 其他工具的预期兼容性，以及 SpectraShape 9000、CIRCL 或 BDR300 工具使用者可以实现的预期成本、运营与其他受益等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港” (Safe Harbor) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题），其他公司推出竞争性产品，或影响 KLA-Tencor 产品的实现、性能或使用的意外技术挑战或限制，实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。

###